【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【公開番号】特開2005-353670(P2005-353670A)
【公開日】平成17年12月22日(2005.12.22)
【年通号数】公開・登録公報2005-050
【出願番号】特願2004-169982(P2004-169982)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/60　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/92　　６０２Ｇ
Ｈ０１Ｌ　21/92　　６０３Ａ
Ｈ０１Ｌ　21/92　　６０４Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成19年5月31日(2007.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電極バンプが形成された基板を用意する工程と、
前記電極バンプを平板で押圧し、前記電極バンプの表面を半球面化する工程とを備えたことを特徴とする電極バンプが形成された基板の製造方法。
【請求項２】
前記電極バンプは塑性変形能を有する材料であることを特徴とする請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
前記塑性変形能を有する材料が、Ａｕ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｓｎ又はこれらの合金の何れかであることを特徴とする請求項１記載の製造方法。
【請求項４】
前記電極バンプを平板で押圧する工程において、前記バンプ表面を平滑化することを特徴とする請求項１記載の製造方法。
【請求項５】
前記電極バンプを平板で押圧する工程の後に、前記電極バンプが形成された基板を熱処理することを特徴とする請求項１記載の製造方法。
【請求項６】
前記電極バンプは変形過程において、前記電極バンプの側面から転移線が抜け出る形状であることを特徴とする請求項１記載の製造方法。
【請求項７】
電極バンプが形成された基板とパッドが形成された基板を用意する工程と、
前記電極バンプが形成された基板と前記パッドが形成された基板を相対向し、前記両基板を押圧することにより、前記電極バンプと前記パッドとを接合する工程とを備え、
前記電極バンプと前記パッドとの接合の前に、前記電極バンプを平板で押圧し、前記電極バンプの表面を半球面化する工程を備えることを特徴とする接合方法。